

证券简称：晶合集成

证券代码：688249

合肥晶合集成电路股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-002

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒电话会议 ☐其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	共 20 家机构，参会机构名单详见附表。
会议时间	2025 年 8 月 29 日
会议地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	朱才伟 董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理 黎翠绫 企划协理 曹宗野 证券事务代表
投资者关系活动主要内容介绍	董秘介绍公司 2025 年上半年业绩情况： 2025 年上半年实现营业收入约 52 亿，较去年同期增长 18.21%；净利润 2.32 亿，较去年同期增长 19.07%；归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润都较去年同期有大幅的增长，分别为3.32 亿和 2.04 亿，较去年同期分别增长 77.61% 和 115.30%。 从制程节点分类看，55nm、90nm、110nm、150nm 占主营业务收入的的比例分别为 10.38%、43.14%、26.74%、19.67%，55nm 营收占比继续提升；从应用产品分类看，DDIC、CIS、PMIC、MCU、Logic 占主营业务收入的的比例分别为 60.61%、20.51%、12.07%、2.14%、4.09%，产品结构继续优化，单一品种比例过大的情况有望持续改善。 问题 1：公司下半年的扩产计划如何？ 答复：公司下半年计划扩产约 2 万片/月。 问题 2：公司目前的研发进展如何？

	答复：目前公司 55nm 堆栈式 CIS 已经量产，预期产量会持续扩大；40nm OLED 显示驱动芯片已量产，于 2025 年上半年开始贡献营收，下半年会逐步放量；28nm OLED 显示驱动芯片预计 2025 年底可进入风险量产阶段。 问题 3：华勤的入股对晶合产品或其他发展是否有变化？ 答复：华勤是智能硬件 ODM 行业的龙头企业，晶合作为成熟制程的晶圆代工厂，部分客户的产品会应用到华勤的终端产品上。本次华勤入股晶合可以促进双方在产业链上下游的资源整合与产业协同，对于晶合的产品将来能够在终端厂商得到验证以及快速上量有所助力。 问题 4：请问 OLED 显示驱动芯片爬坡的进度？未来放量的难点在哪？ 答复：和 LCD 不同的是，OLED 需与面板厂做充分的配套工作，验证周期会比 LCD 更长,这是 OLED 产品产业化的特性。 问题 5：请问公司车用产品的进展如何？ 答复：目前，公司已有部分 DDIC、CIS、PMIC 及 MCU 产品成功应用于汽车领域，且上述产品均已实现量产。 问题 6：请问公司近期产能利用率情况如何？ 答复：公司近期各项业务经营正常，产能利用率仍处于高位水平。 问题 7：请问公司未来研发投入的规划如何？ 答复：公司 2025 年上半年研发投入较去年同期增长 13.13%，展望未来几年，增幅基本维持稳定，系高阶制程研发的战略性投入，待研发成果体现出来，研发投入的增长比例会下降。 问题 8：请问公司到年底扩产的设备是否已经下单？ 答复：相关设备均已下单，公司将根据产能扩充计划陆续进厂。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 9 月 1 日

附表：参会机构名单（排名不分先后）

序号	机构名称	序号	机构名称
1	嘉实基金	11	广州市航长投资管理有限公司
2	野村证券	12	泰康资产管理有限责任公司
3	西藏鸿商资本投资有限公司	13	高盛
4	上海电气集团财务有限责任公司	14	中金公司
5	上海中域投资一中域津和 5 期私募证券	15	中邮证券
6	广银理财有限责任公司	16	UBS
7	国寿安保	17	长城财富
8	银华基金	18	中泰证券
9	兴证证券资产管理有限公司	19	Morgan Stanley
10	深圳市尚诚资产管理有限责任公司	20	华安证券